

世界の 京都の 表現力

NISSHAは印刷を核とした固有の技術を幅広く活用し、環境にやさしい表面加飾、最先端タッチ入力ディバイスなど未来志向のものづくりをグローバルに展開しています。

日本写真印刷株式会社
www.nissha.co.jp

NIECHA

Trend Meets Technology

CEATEC

光る、京都先見の技

京都の電子部品各社が出展

国内最大のＩＴ・エレクトロニクス産業の総合展示会「シーテックジャパン2013」が、千葉県美浜区の幕張メッセで開かれた。次世代映像技術や環境・エネルギー製品、ＩＴと連携した自動車の新サービスなどが会場を席巻。これら先端分野を下支えする電子部品も注目を集めた。京都の電子部品各社も出展し、技術力を存分にアピールした。

スマートフォン関連製品も引き続き活況を呈している。京セラは雑踏の中でも音声が聞き取りやすい「スマートソニック」機能などを搭載したスマートフォン端末を紹介。好調な北米市場向け端末を中心に、顧客ニーズに合った独自でユニークな製品ラインアップをアピールした。

京セラは2013年度の世界端末出荷台数を前年度比9%増の約120万台に設定。このうち7割を北米を中心とする

海外に供給する方針だ。8月には米携帯電話最大手のベライゾン・ワイヤレス向けに供給を始めた。供給先の通信事業者を増やし、北米市場の深耕を加速。国内向け端末との両輪で成長軌道を描く。

ロームは新工法を用いた超小型のディスクリート（個別半導体）製品群「RASMD（ラスミッド）シリーズ」を完成。0.402（0.4ミリ×0.2ミリ×0.2ミリ）サイズのショットキーバリアーダイオード（SBD）や、

村田製作所は電子機器のノイズを除去するチップフェライトピーブズで、世界最小の「0201（0.25×0.125ミリ）」サイズを開発した。現在一部のスマートフォンに搭載される0.1

SBDでは超精密加工技術などを駆使し、従来品の0.603（0.6ミリ×0.3ミリ）に比べ、体積を82%、チップ抵抗器では56%低減することに成功した。

デンシは通話時の誤作動を防ぐ近接センサーの試作品を披露した。オムロンは機器に触わらずにスマートフォンなどを操作できる画像センシングソフトウエア「ハンディエスチャ―認識バージョン2」を開発した。左右角30度・上下角同20度と、従来より手の角度の対応範囲を拡大。より自然な動作で機器を操作できる。

自動車

これが、
私の新しい
日本酒。

白壁蔵の里 MIO

5%

よ、印ヤレ、お臘み、たどり。